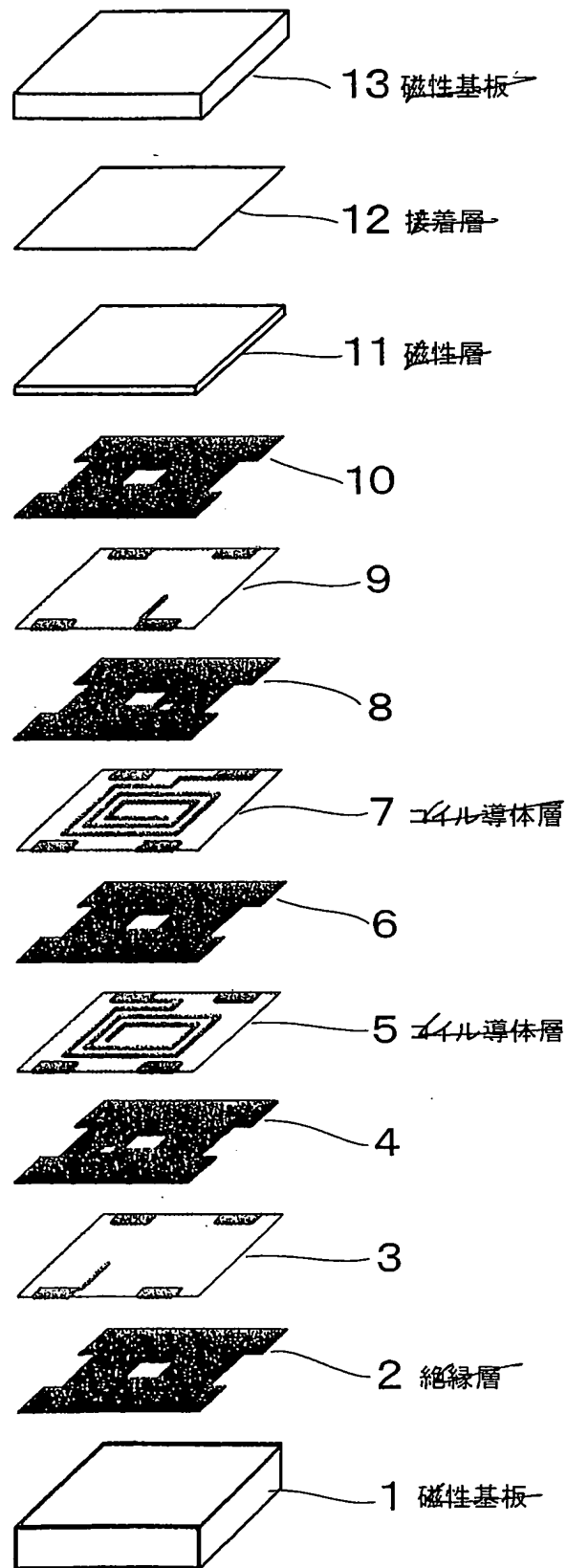


Fig. 1



【図2】

Fig. 2 (A)

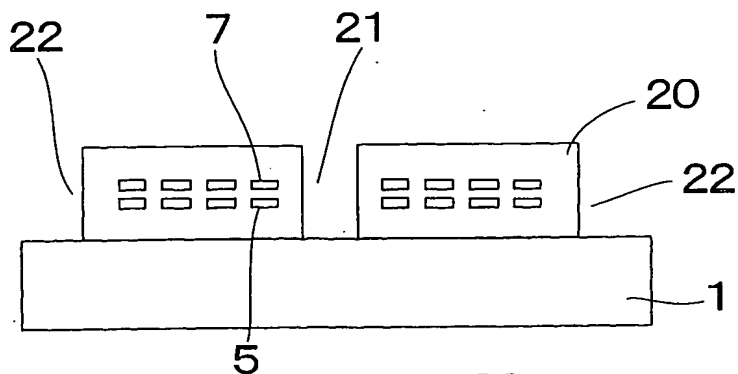


Fig. 2 (B)

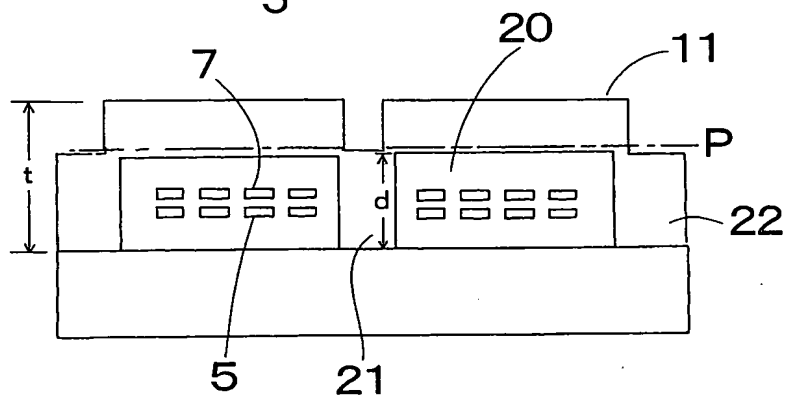
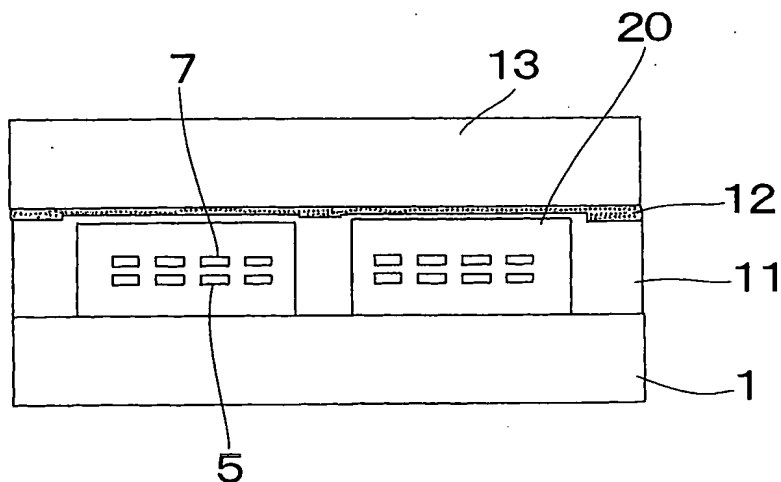


Fig. 2 (C)

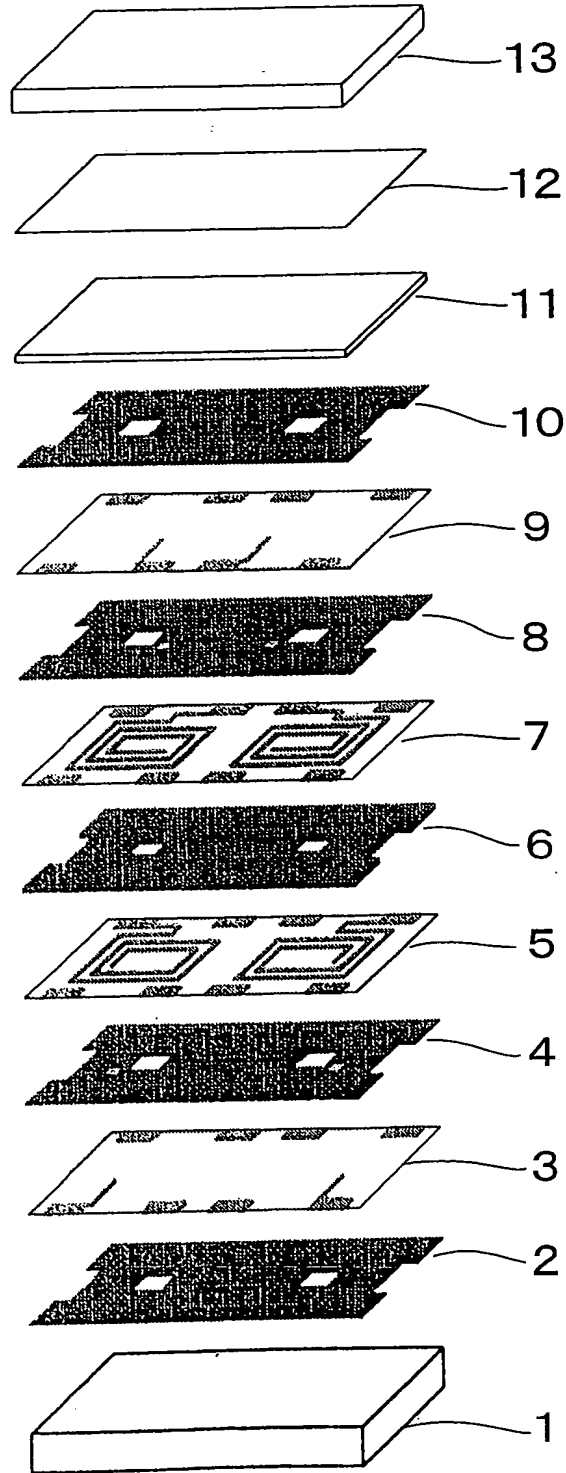


整理番号=B 2 1

提出日 平成15年 2月26日
特願2003-050016 頁: 4/ 4

【図3】

Fig. 3

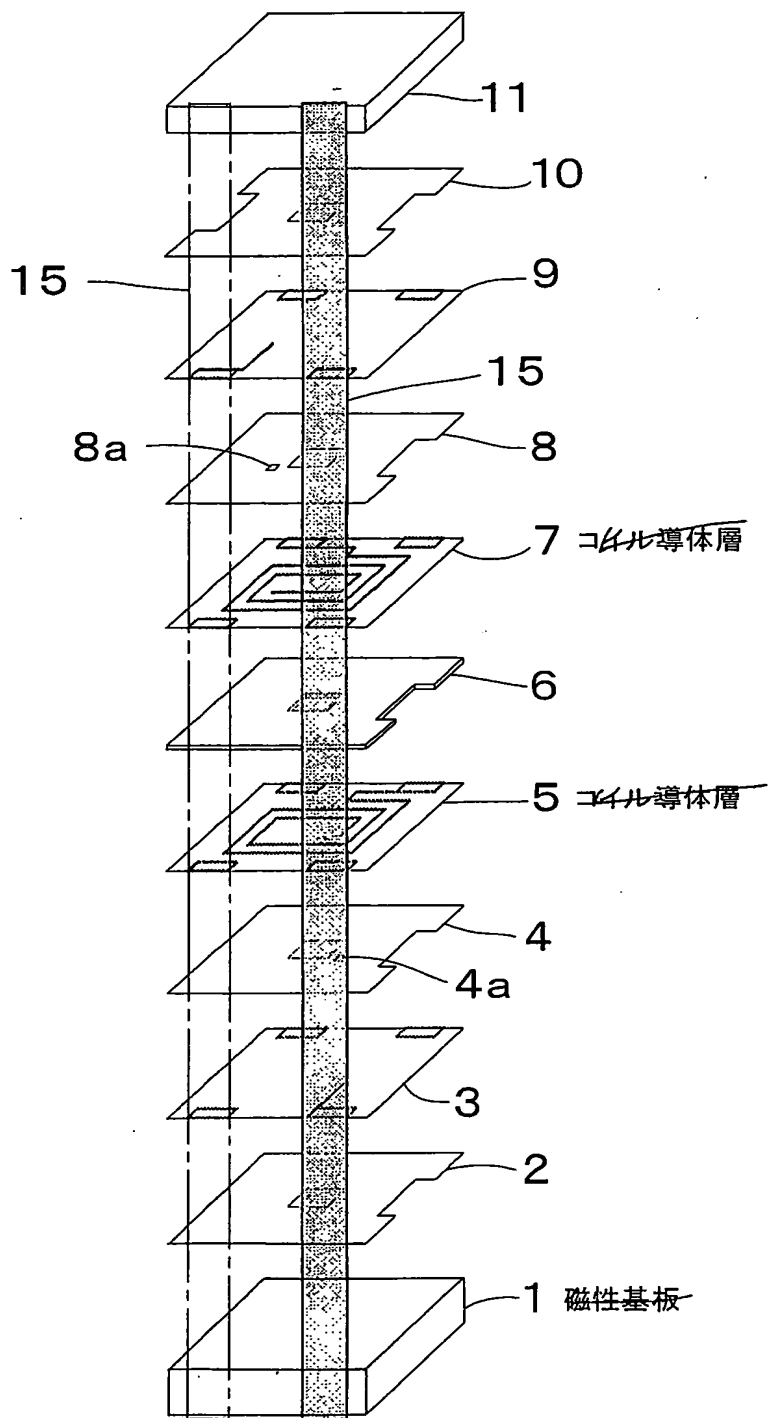


【書類名】

図面

【図1】

Fig. 4

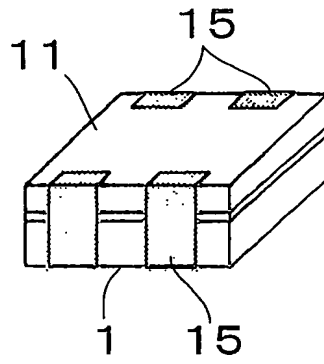


整理番号=B 2 2

提出日 平成 1 5 年 2 月 2 6 日
特願2003-050124 頁: 2/ 5

[図2]

Fig. 5

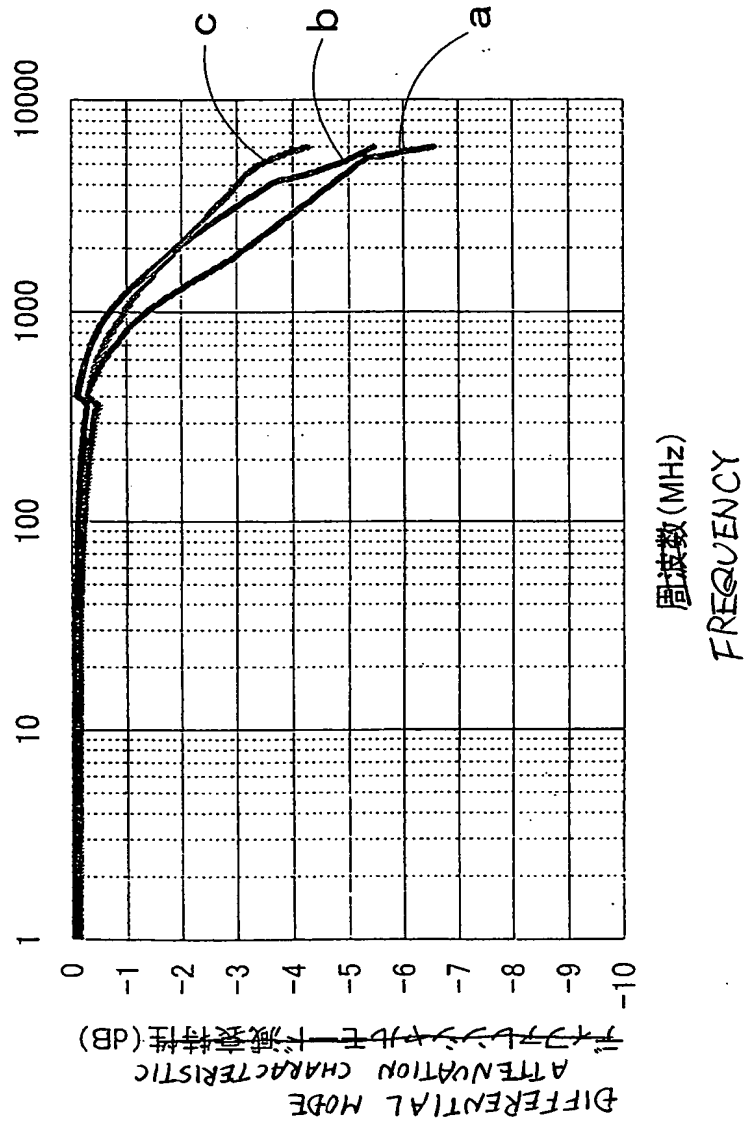


整理番号=B 2 2

提出日 平成15年 2月26日
特願2003-050124 頁: 3/ 5

【図3】

Fig. 6



整理番号=B 2 2

提出日 平成15年 2月26日
特願2003-050124 頁: 4/ 5

【図4】

Fig. 7 (A) ~~SPUTTERING OF~~ Cr/Cu or Ti/Cu
Cr/Cu又はTi/Cuスパッタ

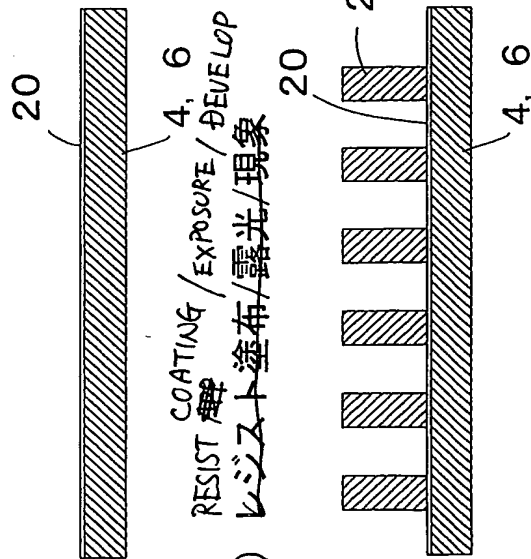
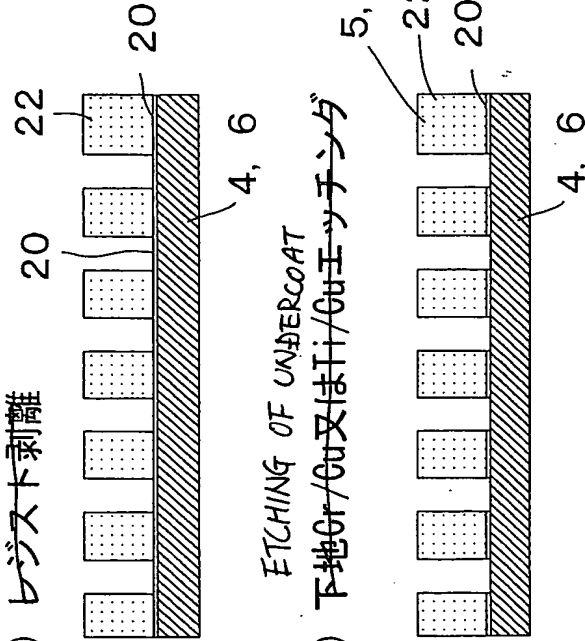


Fig. 7 (B) COATING / EXPOSURE / DEVELOP
レジスト塗布/露光/現象

REMOVING OF RESIST
レジスト剥離



ETCHING OF UNDERCOAT
下地Cr/Cu又はTi/Cuエッチング

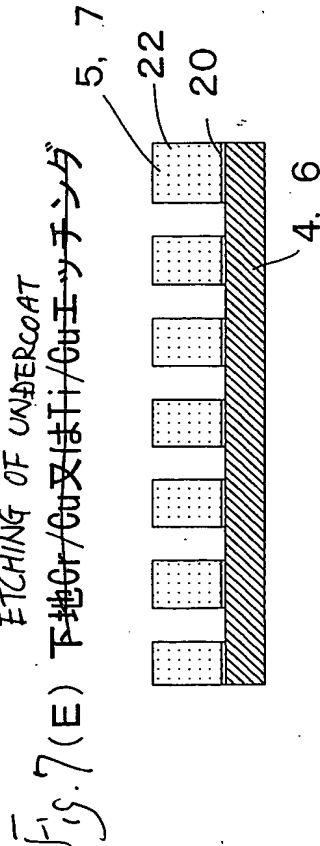


Fig. 7 (C) Cu ELECTROPLATING
Cu電気めっき

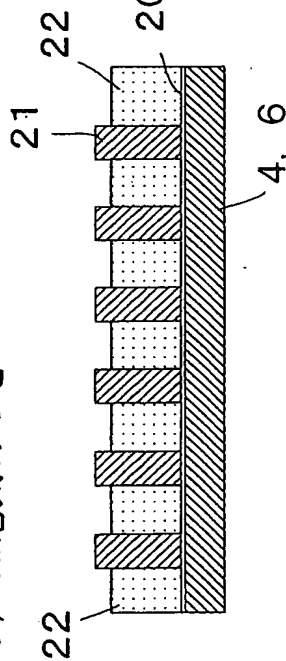
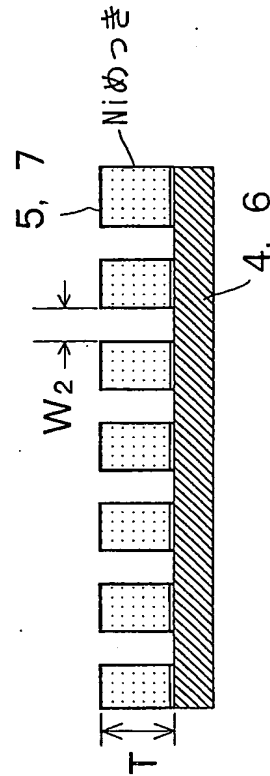


Fig. 7 (F) Ni ELECTROPLATING
Ni電気めっき



整理番号 = B 2 2

提出日 平成 1 5 年 2 月 2 6 日
特願 2003-050124 頁: 5 / 5

[図 5]

Fig. 8

